

2019年3月期（2018年4月～2019年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2019年4月26日

内容：

- 2019年3月期 連結決算の概要 経理部長 笹川 謙
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

2019年3月期 連結決算の概要

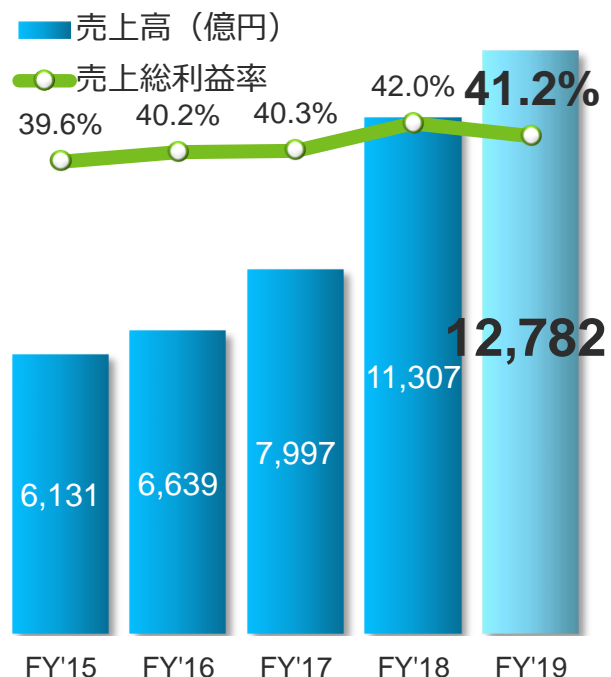
2019年4月26日

笹川 謙
経理部長

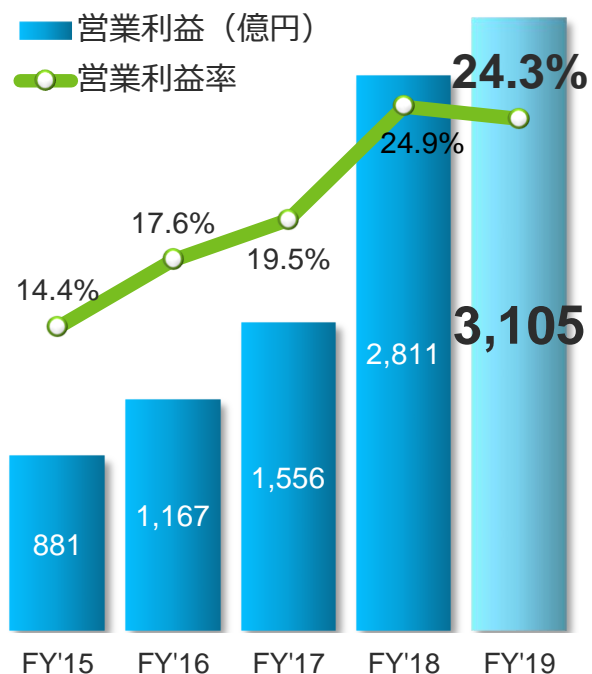


FY2019（2018年4月～2019年3月）ハイライト

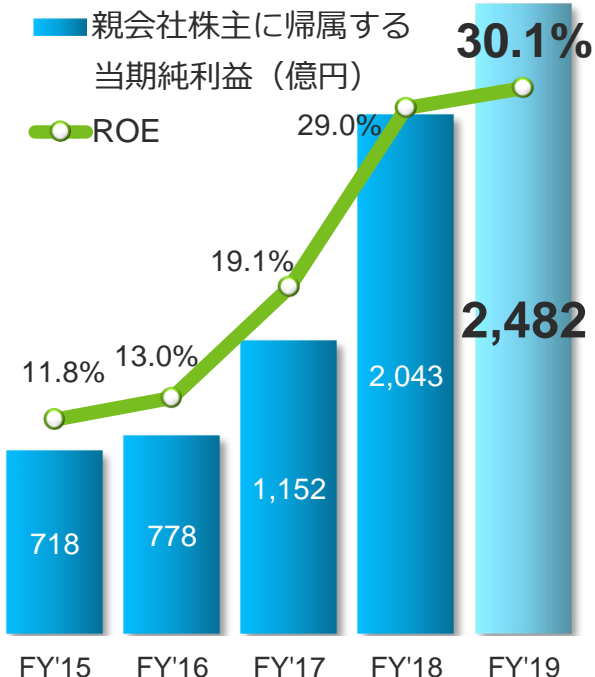
売上高と売上総利益率



営業利益と営業利益率



親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



- 拡大するSPE*1市場における競争力向上と、FPD*2でのシェア拡大により、前期比+13%の増収
- 売上総利益・営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益が過去最高を更新

損益状況

(億円)

	FY2018	FY2019	対前年 増減率	(ご参考) 2018年10月31日発表 のFY2019予想
売上高	11,307	12,782	+13.0%	12,800
SPE	10,552	11,667	+10.6%	11,698
FPD	750	1,112	+48.2%	1,100
売上総利益	4,750	5,261	+10.8%	5,280
下段：売上総利益率	42.0%	41.2%	-0.8pts	41.3%
販管費	1,938	2,156	+11.2%	2,190
営業利益	2,811	3,105	+10.5%	3,090
下段：営業利益率	24.9%	24.3%	-0.6pts	24.1%
税金等調整前当期純利益	2,752	3,215	+16.8%	3,150
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,043	2,482	+21.5%	2,370
1株当たり当期純利益 (円)	1,245.48	1,513.58	+21.5%	1,445.13
研究開発費	971	1,139	+17.4%	1,160
設備投資額	456	497	+9.1%	510
減価償却費	206	243	+18.0%	260

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）

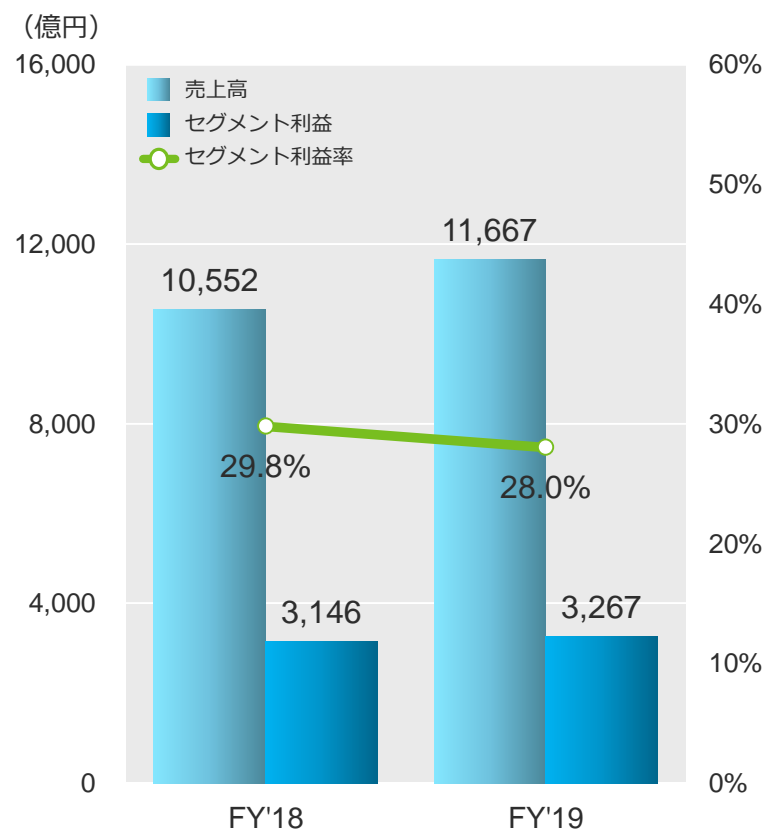
(億円)

	FY2018	FY2019				対FY2019 Q3 増減率
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
売上高	3,559	2,955	3,954	2,681	3,190	+19.0%
SPE	3,260	2,804	3,580	2,395	2,887	+20.6%
FPD	297	151	373	285	301	+5.6%
売上総利益	1,535	1,224	1,616	1,097	1,322	+20.5%
下段：売上総利益率	43.1%	41.4%	40.9%	40.9%	41.5%	+0.6pts
販管費	537	500	586	510	558	+9.5%
営業利益	997	724	1,030	587	764	+30.1%
下段：営業利益率	28.0%	24.5%	26.0%	21.9%	24.0%	+2.1pts
税金等調整前当期純利益	956	752	1,058	605	798	+31.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	729	557	795	488	641	+31.3%
研究開発費	270	261	312	265	300	+13.3%
設備投資額	120	96	132	118	149	+26.6%
減価償却費	60	50	56	62	73	+17.2%

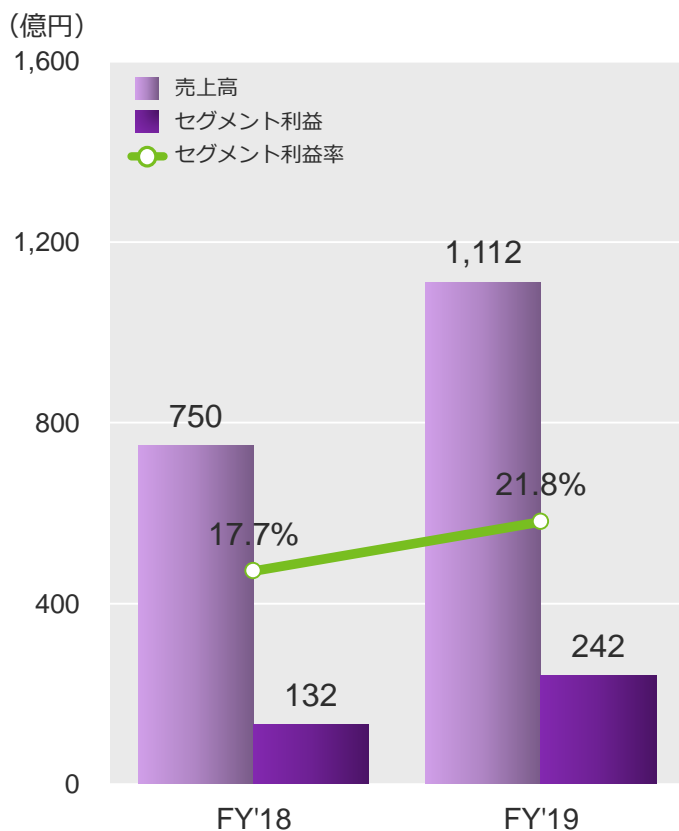
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

セグメント情報

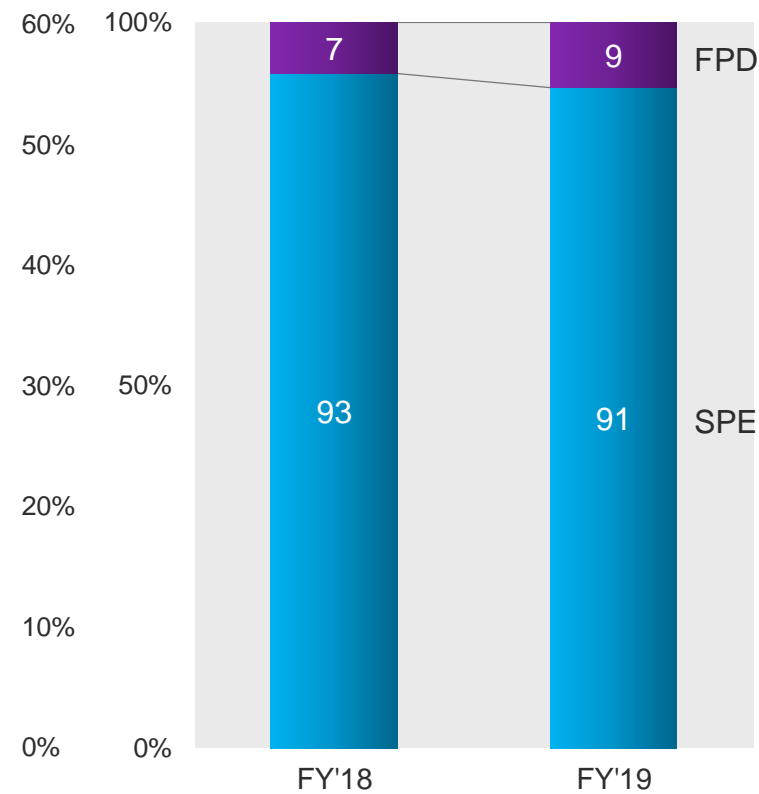
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



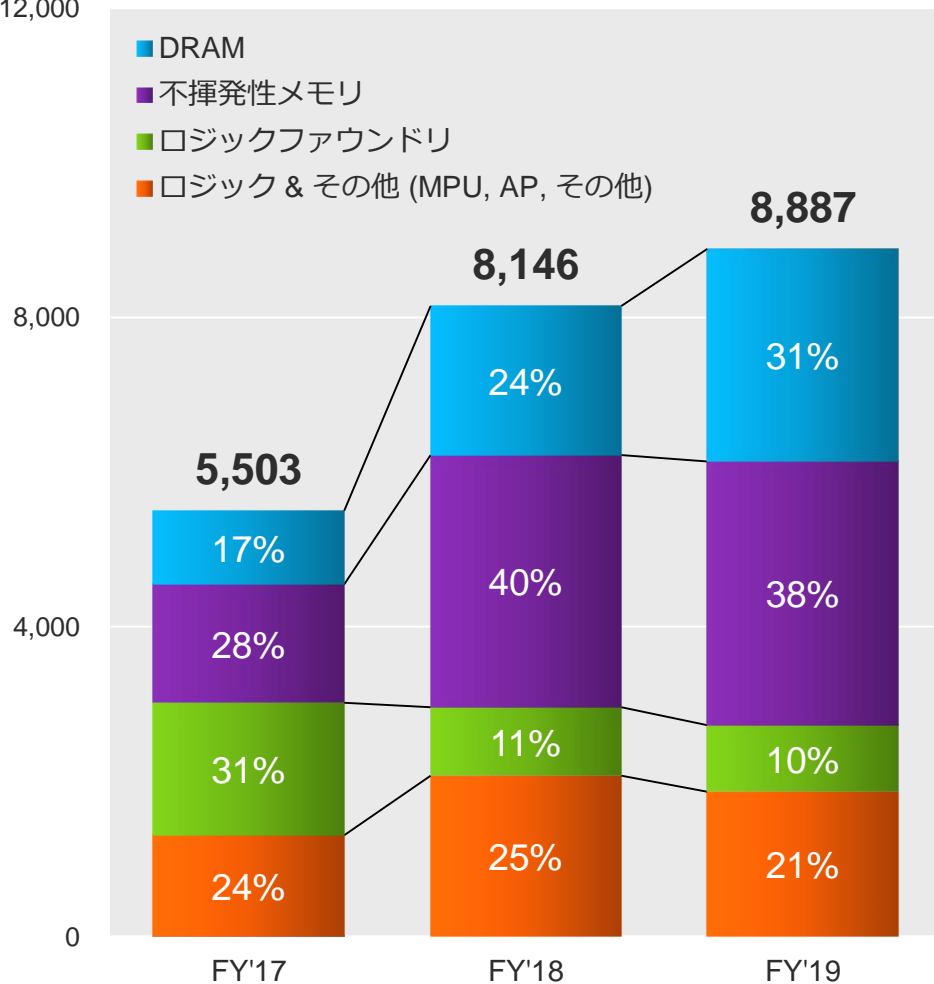
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

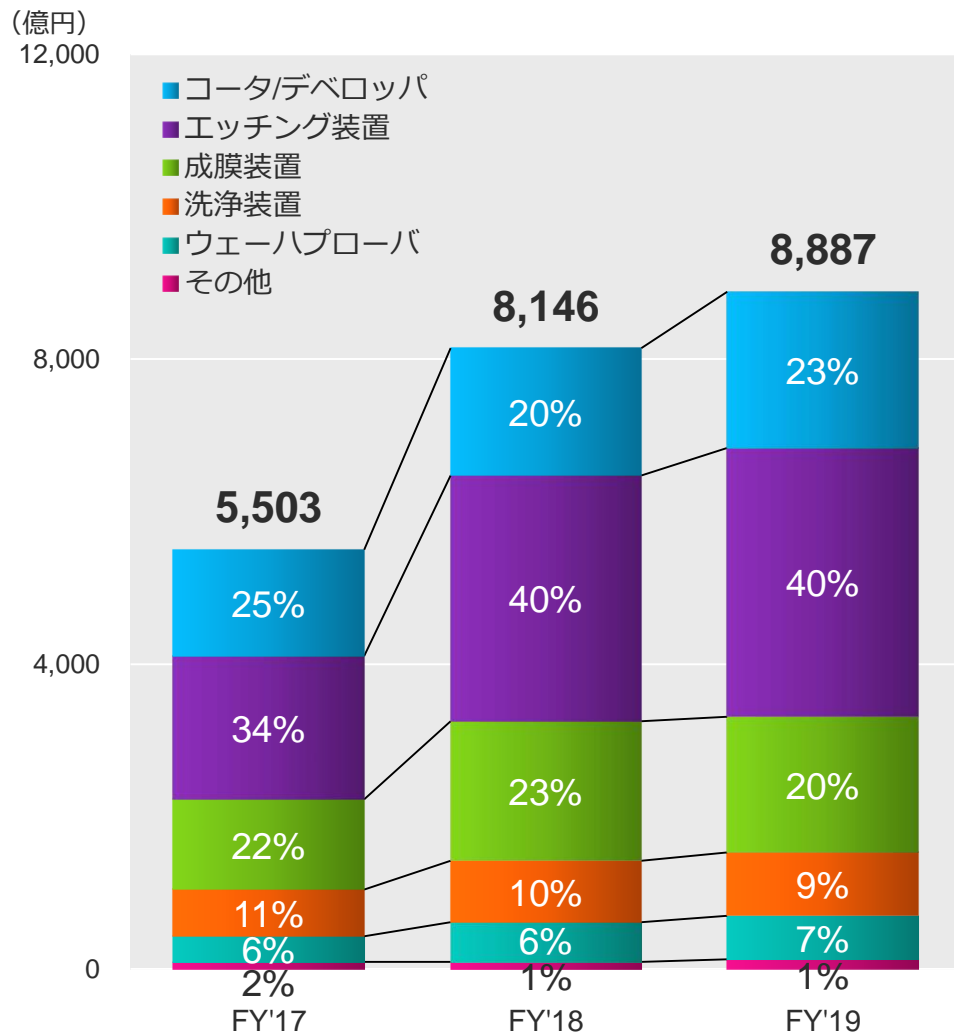
SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比

(億円)
12,000



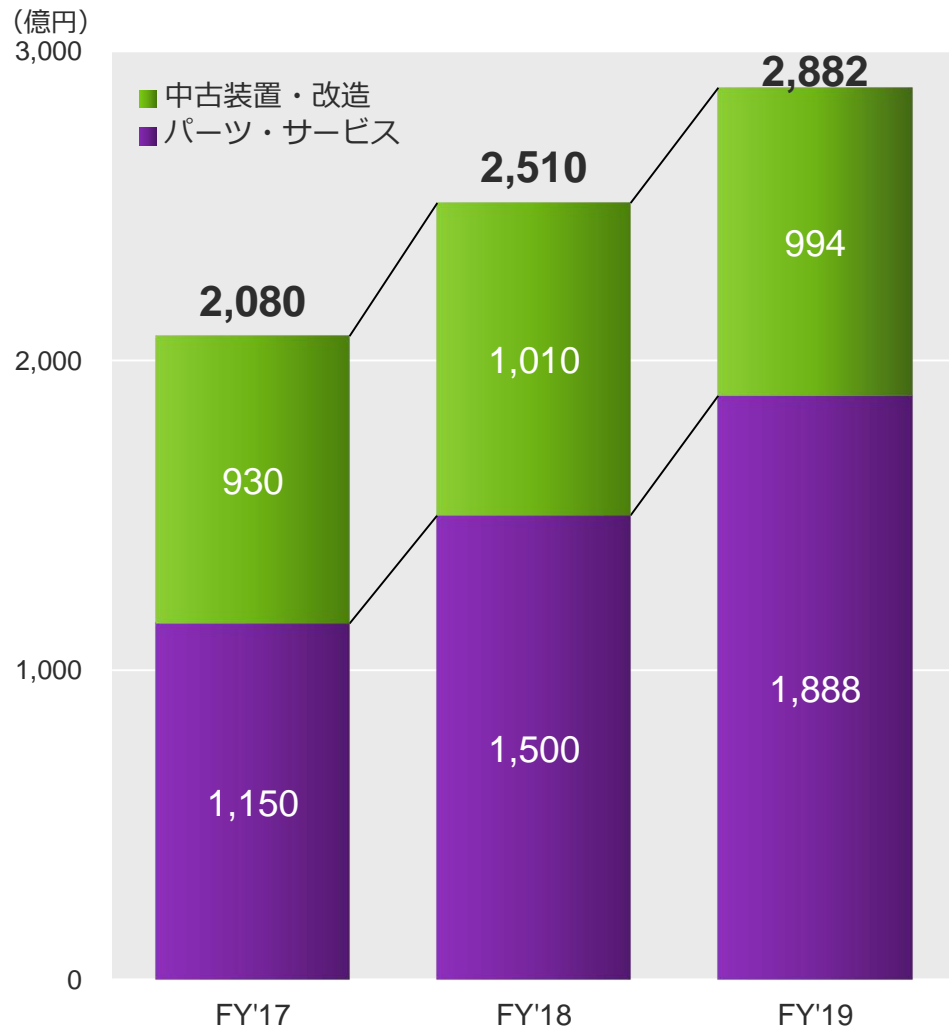
- FY2019は、メモリでは旺盛なサーバ需要にともなう生産能力の増強と最先端技術への投資が堅調
- ファウンドリ/ロジックでは、14nm世代以降への投資が継続

SPE部門 新規装置 製品別売上構成比



- FY2019はコータ/デベロッパ、エッチング装置の売上が拡大

フィールドソリューション売上高

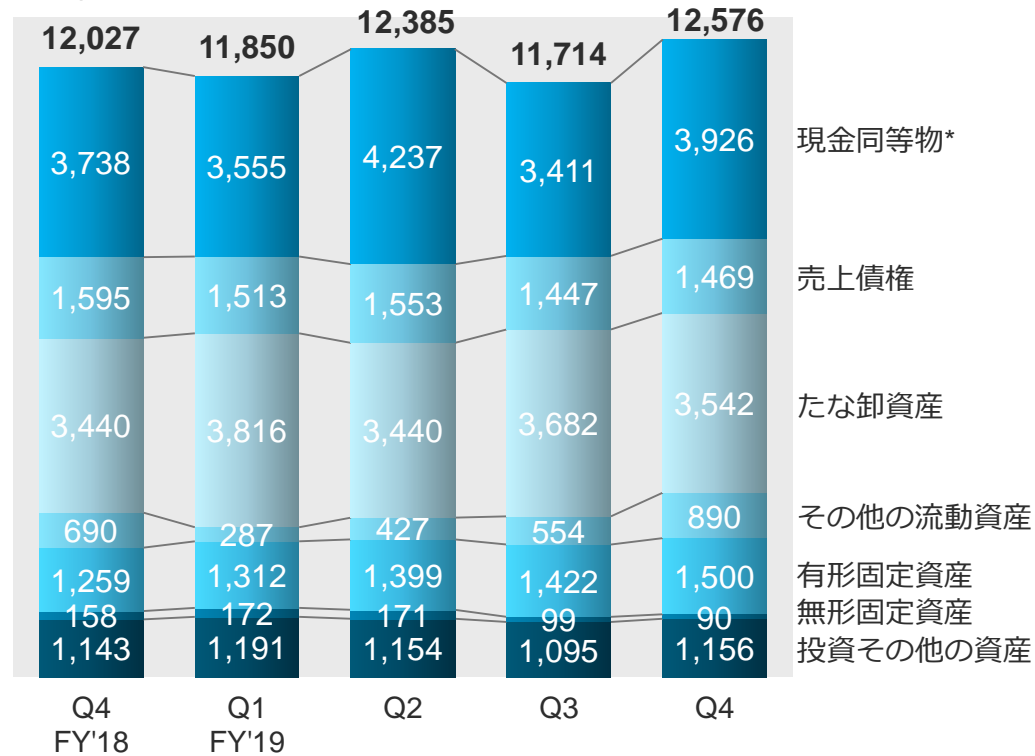


- FY2019の売上は、前期比+15%の2,882億円。インストールベースと包括サービス契約の増加により、特にパーツ売上が拡大

貸借対照表（四半期）

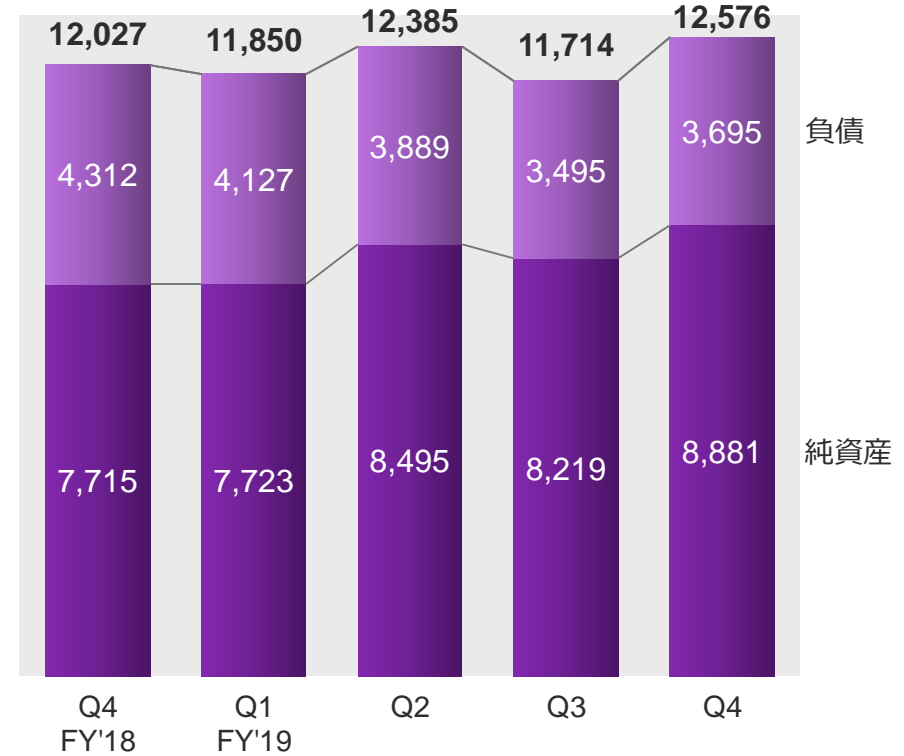
資産

(億円)



負債・純資産

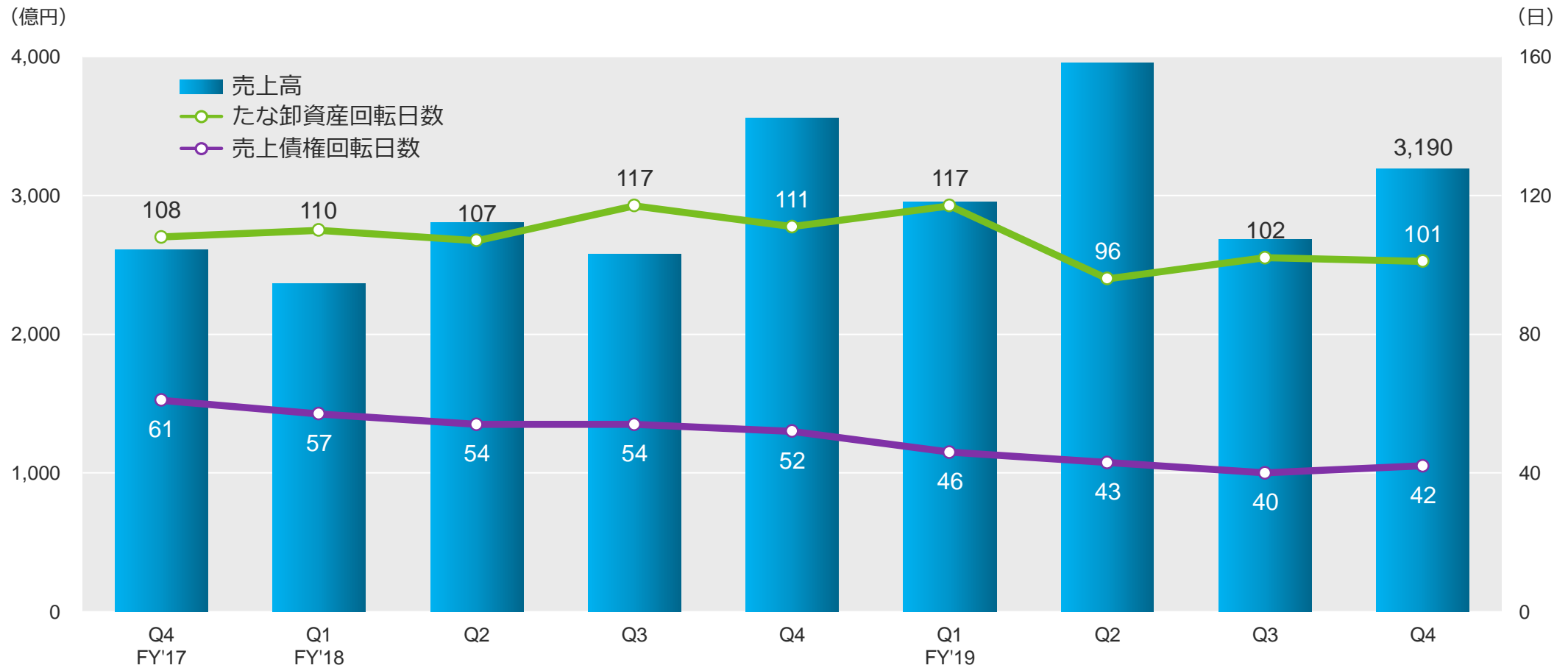
(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

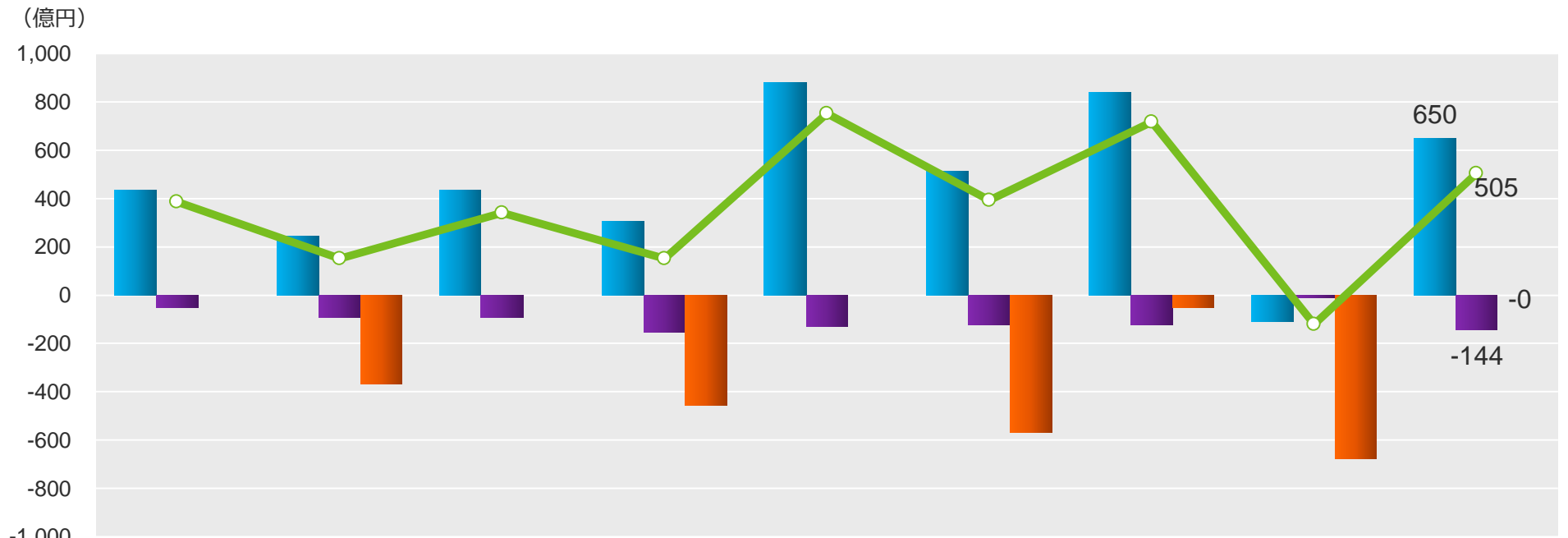
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）をFY2019 Q1会計期間の期首から適用しており、FY2018の実績については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しています。

たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー（四半期）



	Q4 FY'17	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4
■ 営業キャッシュ・フロー	436	244	434	304	881	514	840	-110	650
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-49	-93	-94	-152	-128	-121	-122	-11	-144
■ 財務キャッシュ・フロー	-0	-368	-0	-457	-0	-569	-50	-678	-0
● フリーキャッシュ・フロー*2	387	151	340	151	753	393	717	-121	505
手元資金残高*3	3,153	2,946	3,299	3,012	3,738	3,555	4,237	3,411	3,926

*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

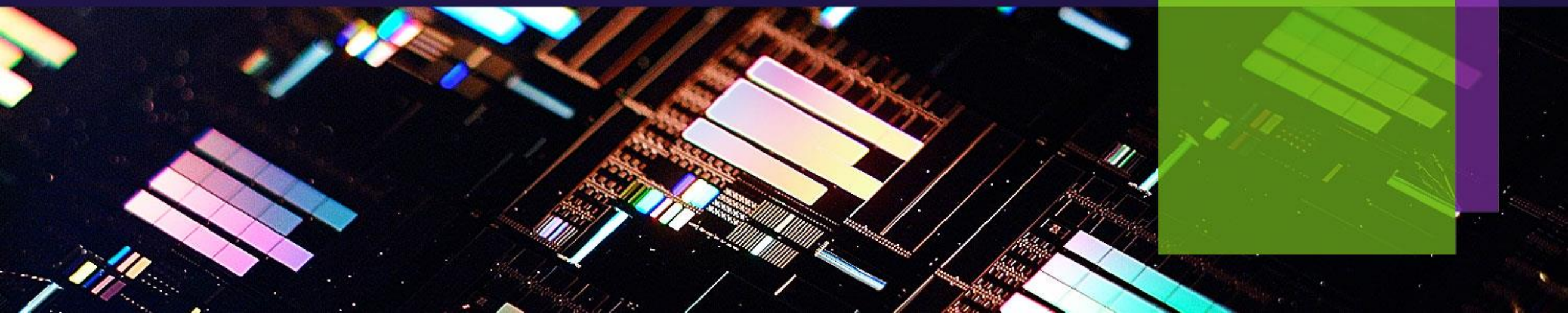
*2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー（満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く）

*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

事業環境および業績予想

2019年4月26日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



FY2019 SPE事業のハイライト

コータ/デベロッパ

- シェア88%達成
- 量産EUV向けでシェア100%



エッチング装置

- 3D NAND slit工程
- 中計目標のシェア30%達成 (CY'17比+4pts)
- 宮城 新物流棟、新開発棟 稼動

洗浄装置

- CY'17に上昇したシェア (CY'16比+5pts) を維持
- ベベル洗浄・パターン倒壊防止技術で市場から高い評価



成膜装置

- シェア拡大 (CY'17比+2pts)
- 山梨・東北工場新生産棟着工

ウェーハプローバ

- プローバで2年連続シェアNo.1

成長分野へ注力し、過去最高のWFEシェア15%達成

FY2019 FPD事業のハイライト

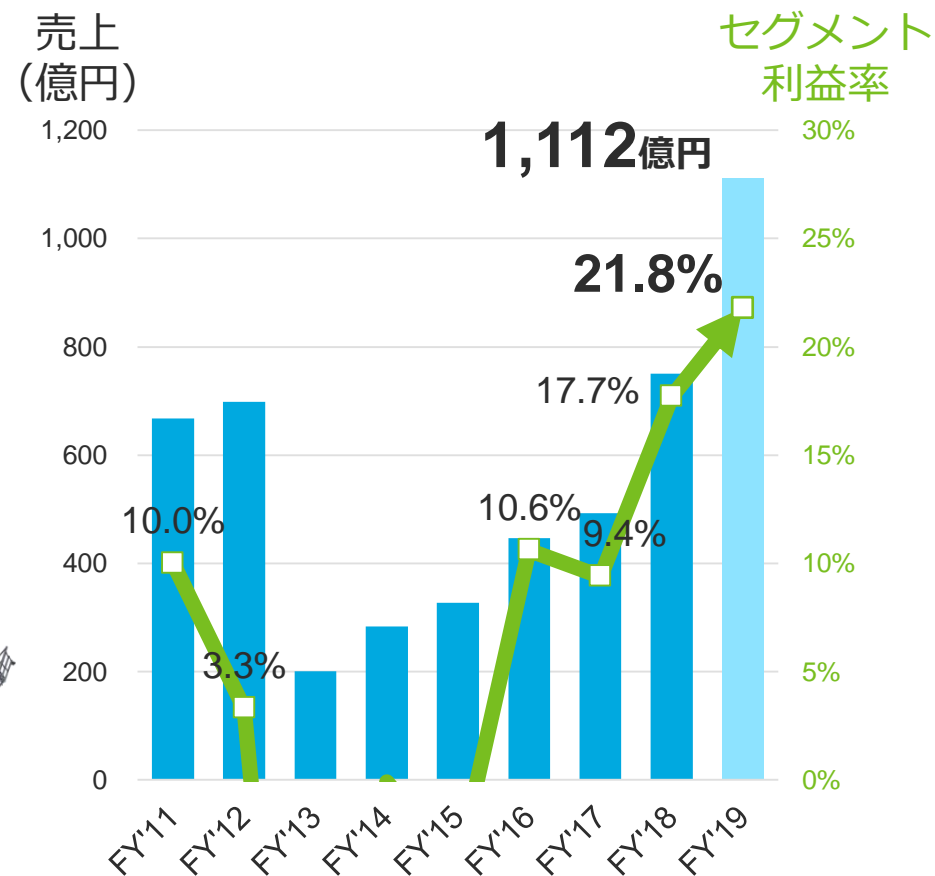
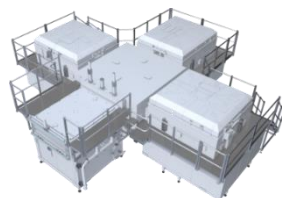
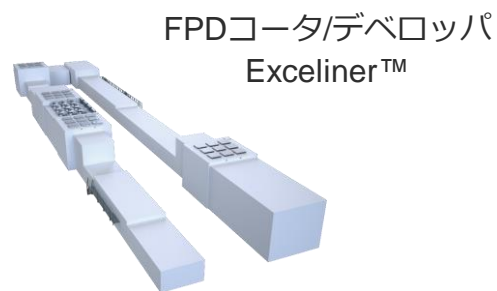
- 売上・営業利益は過去最高、
中計目標の営業利益率20%を達成

- 第10.5世代向け装置の拡販。
売上、利益率向上に貢献

- 新製品の販売開始

– 高精細FPD向け
第10.5世代プラズマエッチング装置
Impressio™ 3300 PICP*™

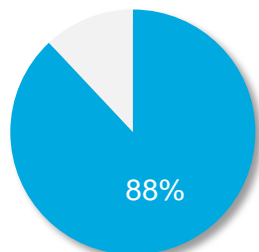
– 有機ELディスプレイ向け
第4.5世代インクジェット描画装置
Elius™ 1000



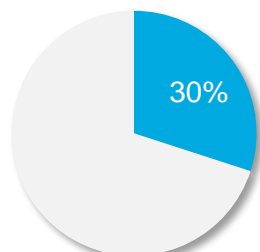
過去最高の売上達成と利益率の大幅改善

TEL 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2018)

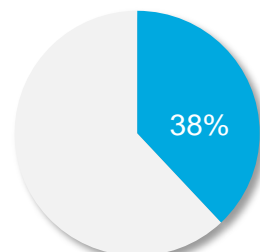
半導体製造装置



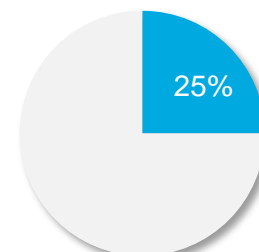
コータ/デベロッパ



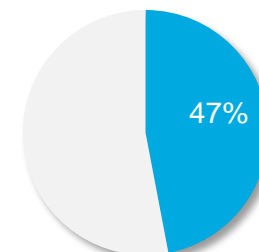
ドライエッチング装置



成膜装置

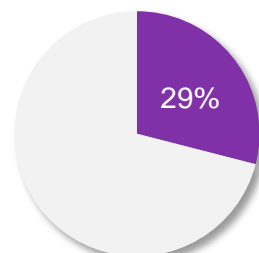


洗浄装置

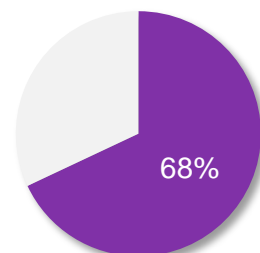


ウェーハプローバ*

FPD製造装置 (FY2019)

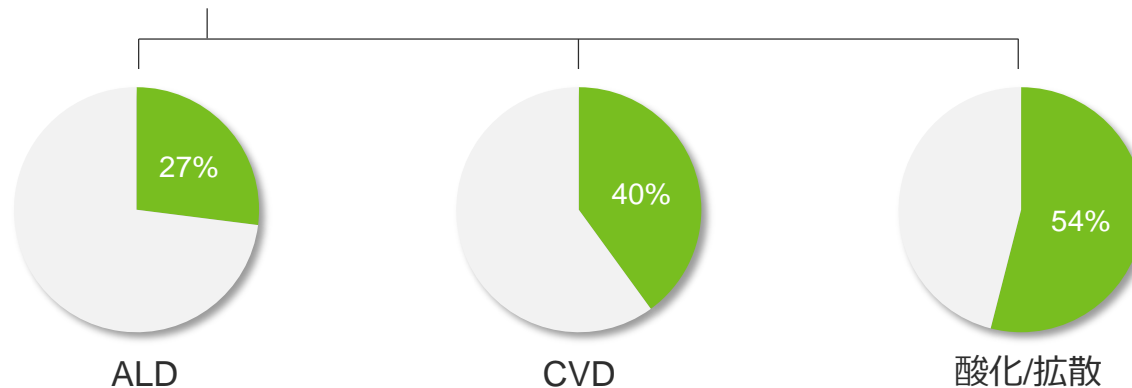


FPDコータ/デベロッパ



FPDプラズマエッチング装置

出所 (FPD) : 当社推定



出所

SPE (ウェーハプローバを除く) : Gartner, "Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2018", Bob Johnson, Gaurav Gupta et al, 24 April 2019

図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。

コータ/デベロッパ: Photoresist processing (Track), ドライエッチング装置: Dry etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic layer deposition tools + Oxidation/diffusion furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic layer deposition tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet stations +Batch Spray processors + Other clean process

* SPE (ウェーハプローバ) : VLSI Research, April 2019

図はVLSI Researchに基づき、東京エレクトロンが作成。

事業環境（2019年4月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2019の投資は、前年比15～20%程度の減少を想定。ロジック/ファウンドリ向けは堅調も、メモリは需給の軟化により一時的に投資調整。ただし、在庫調整は着実に進み、NANDは年後半から、DRAMはCY2020初頭より回復の兆し

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

CY2019は、モバイル用途のOLEDパネル向け設備投資が軟調、大型パネル向けは一時的に投資調整。通年では前年比30%程度の減少も年後半から回復基調に転じると期待

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2019 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年比25%程度増加
 - 市場環境：世代移行による設備投資増加。10nm以細の世代向けが5割を占める
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比30%程度減少。CY2020初頭からの回復を期待
 - 市場環境：設備投資の6割以上が1Y/1Znm世代向け
 - 事業機会：最先端世代における一括パターンニング
- 不揮発性メモリ：前年比50%程度減少も年後半から回復の兆し
 - 市場環境：歩留向上により生産能力の増強投資は調整中だが、在庫は着実に減少中。9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

FY2020 業績予想

FY2020 業績予想

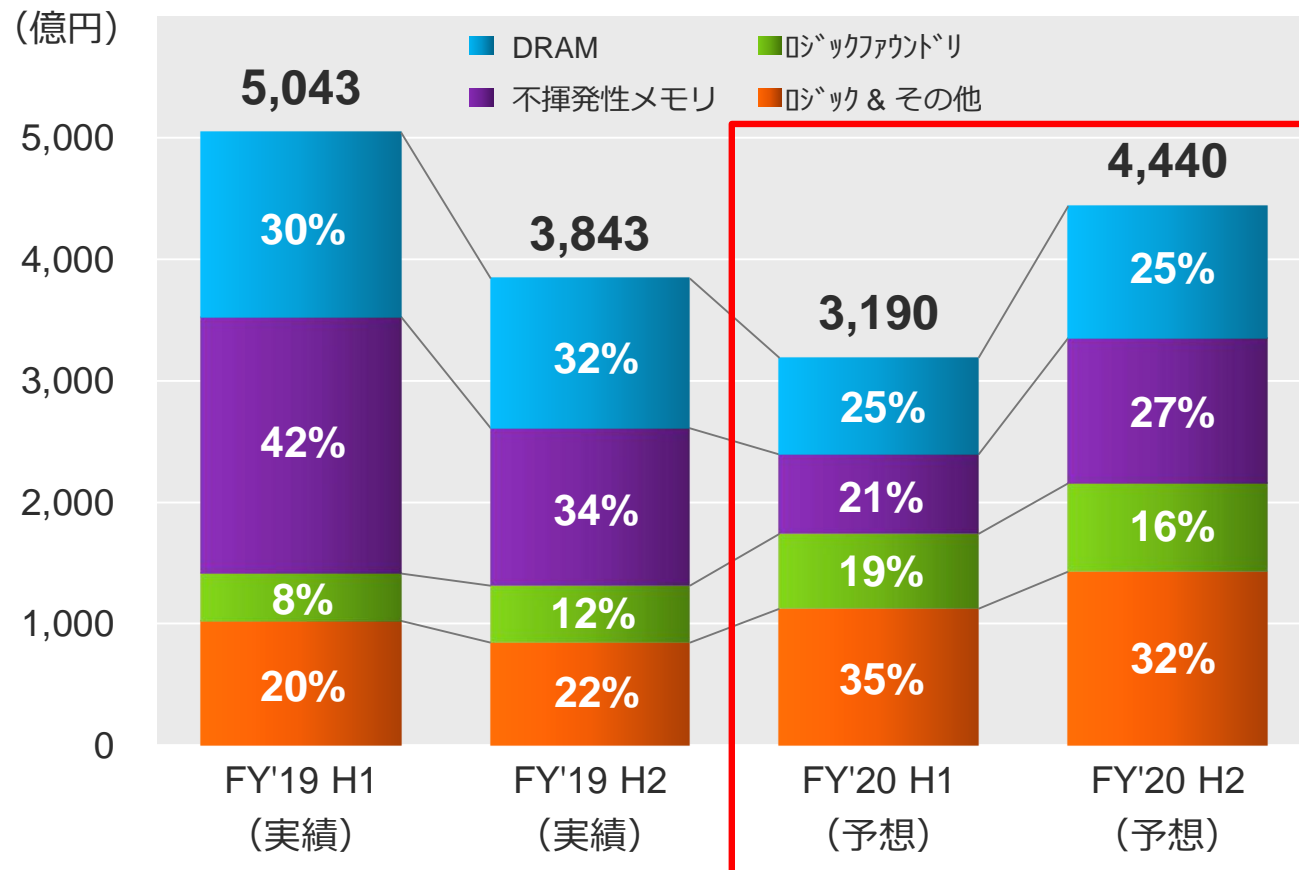
(億円)

	FY2019 (実績)	FY2020 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	12,782	4,900	6,100	11,000	-13.9%
SPE	11,667	4,500	5,800	10,300	-11.7%
FPD	1,112	400	300	700	-37.1%
売上総利益	5,261	1,920	2,490	4,410	-851
下段：売上総利益率	41.2%	39.2%	40.8%	40.1%	-1.1pts
販管費	2,156	1,070	1,140	2,210	+53
営業利益	3,105	850	1,350	2,200	-905
下段：営業利益率	24.3%	17.3%	22.1%	20.0%	-4.3pts
税金等調整前当期純利益	3,215	850	1,350	2,200	-1,015
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,482	630	1,010	1,640	-842
1株当たり当期純利益 (円)	1,513.58	384.24	-	1,000.25	-513.33

市場は調整局面も、来年の市場回復に向けて成長投資を継続

FY2020 SPE部門 新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比

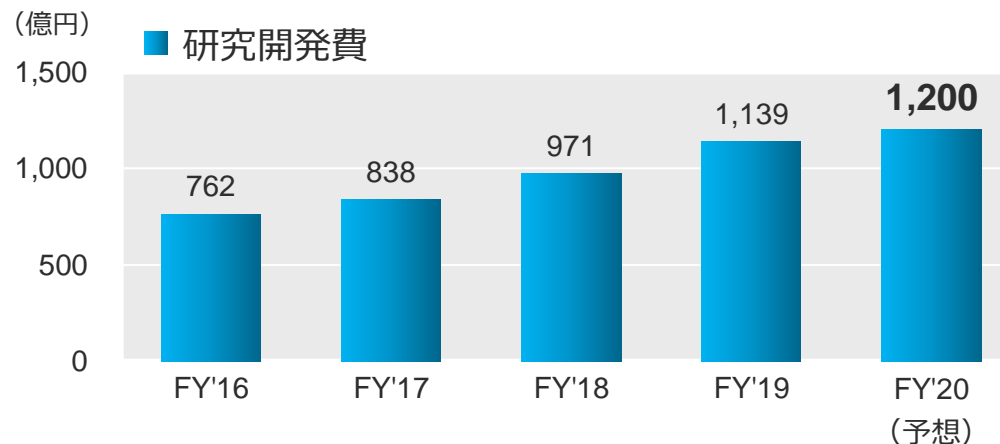


- DRAM
 - 年後半にかけて需給の調整が進む
- 3D NAND
 - DRAMより先に下期から回復の兆し
- ロジック/ファウンドリ
 - 10nm世代以降への投資が増加
 - 28nm世代以前への投資も堅調

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

FY2020 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 1,200億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 330億円



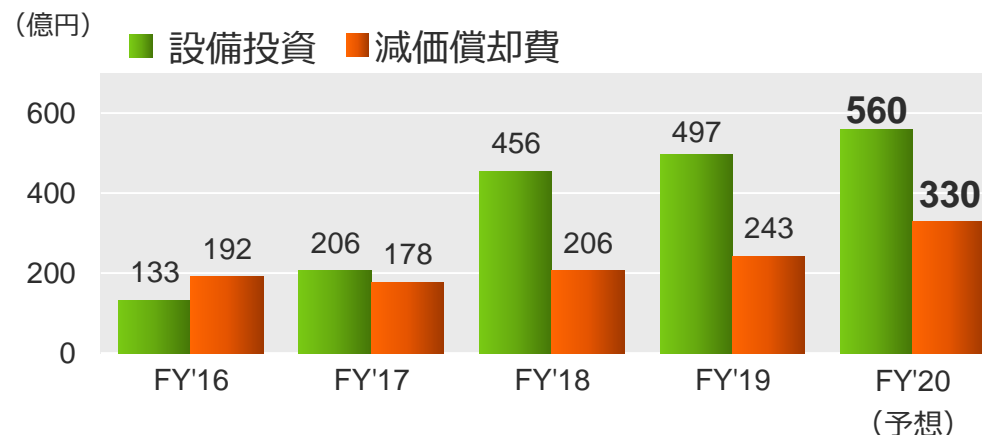
新生産棟の建設
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士崎市：建設費約130億円
(2019年2月着工、2020年4月竣工予定)



岩手県奥州市：建設費約130億円
(2018年10月着工、2019年9月竣工予定)



中期計画達成とさらなる成長を視野に先行投資を継続

FY2020 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

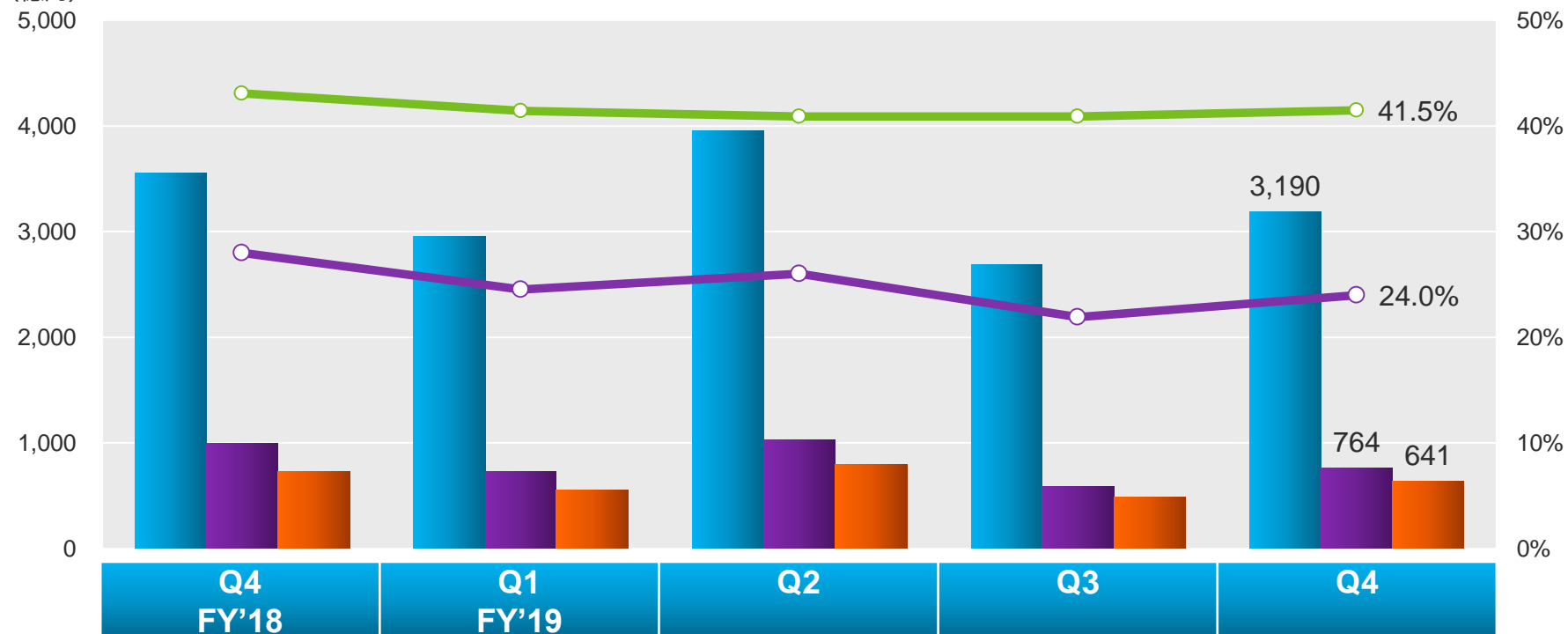
自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、配当性向 50%に沿って 502円を予定

補足資料

損益状況 (四半期)

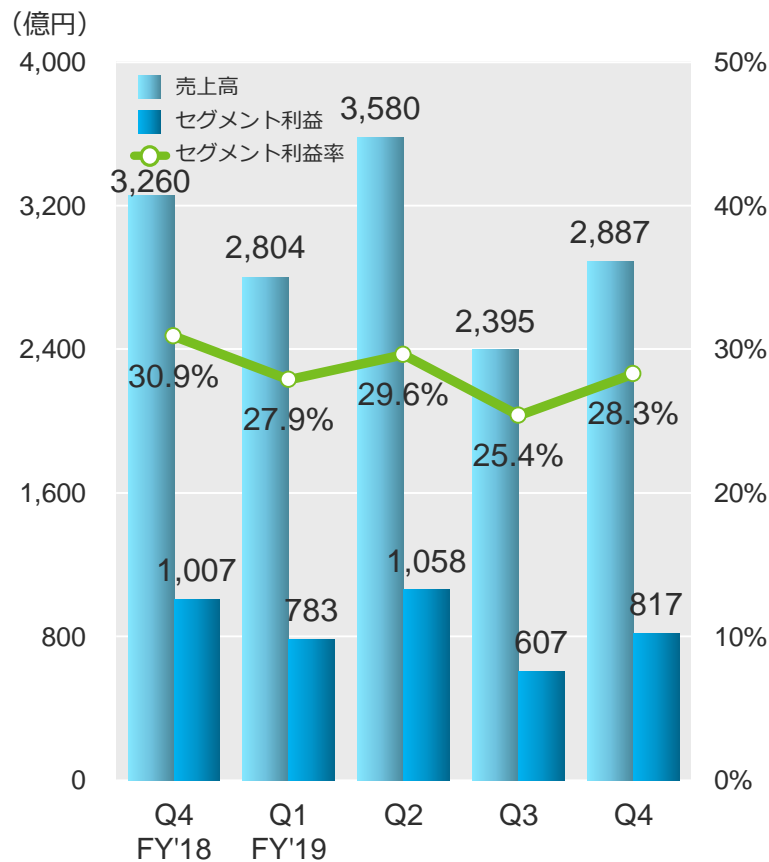
(億円)



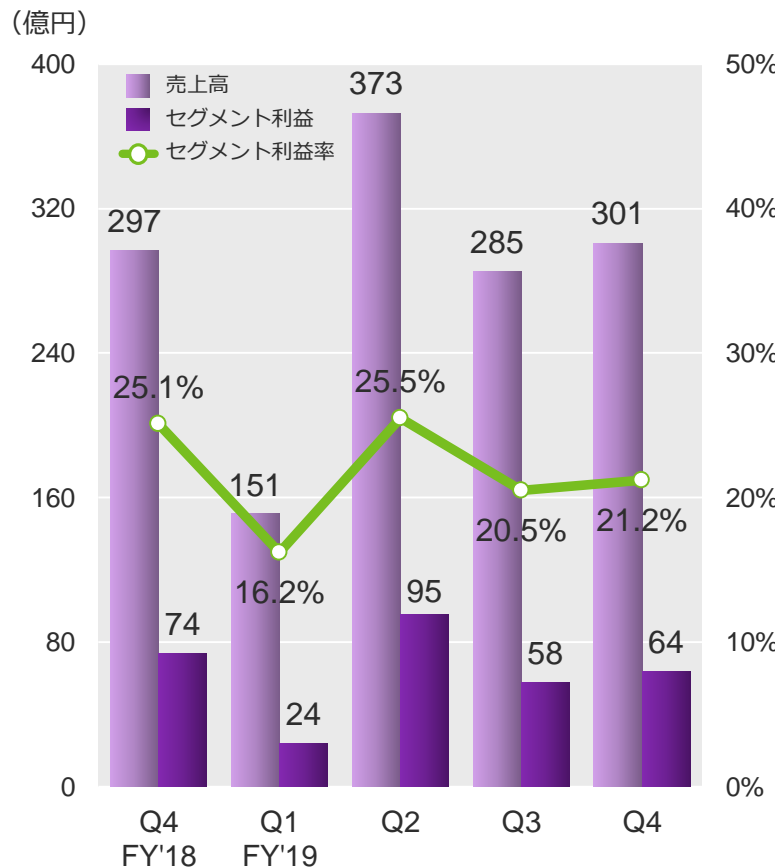
売上高	3,559	2,955	3,954	2,681	3,190
営業利益	997	724	1,030	587	764
親会社株主に帰属する当期純利益	729	557	795	488	641
売上総利益率	43.1%	41.4%	40.9%	40.9%	41.5%
営業利益率	28.0%	24.5%	26.0%	21.9%	24.0%

セグメント情報（四半期）

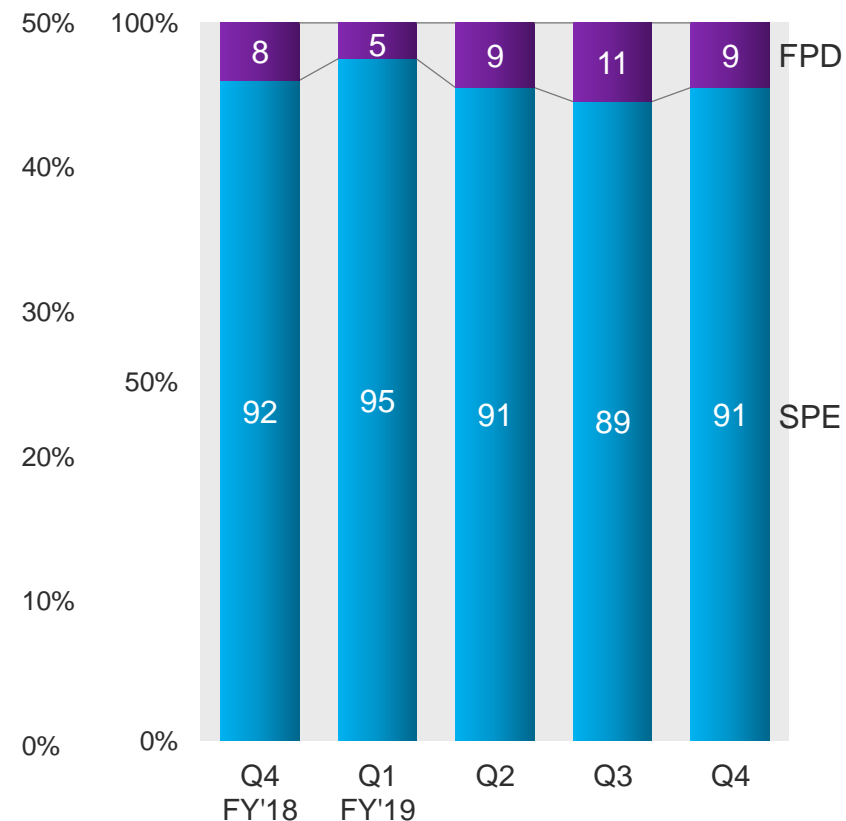
SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）



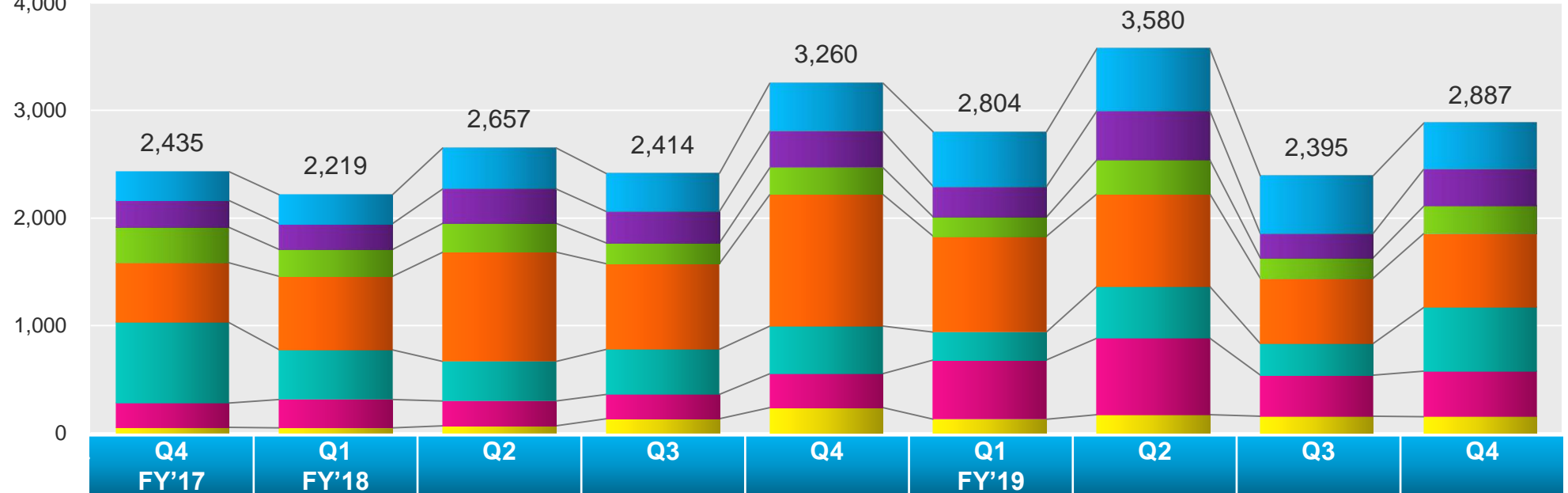
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

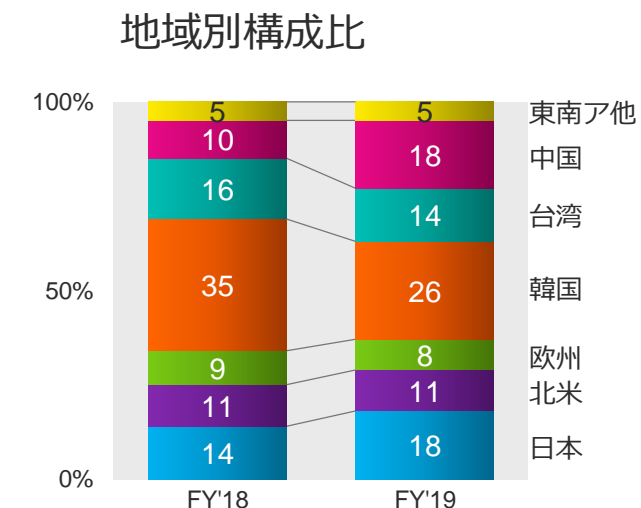
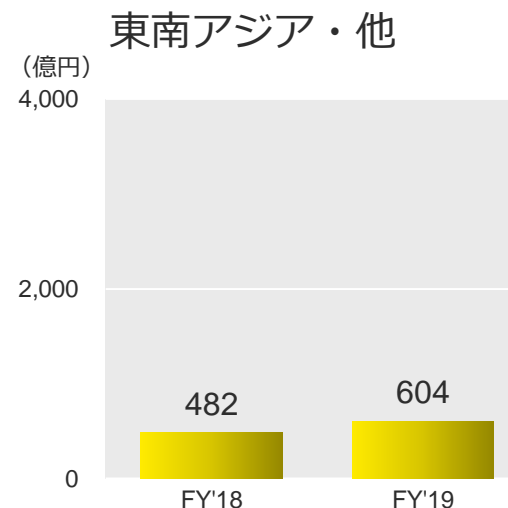
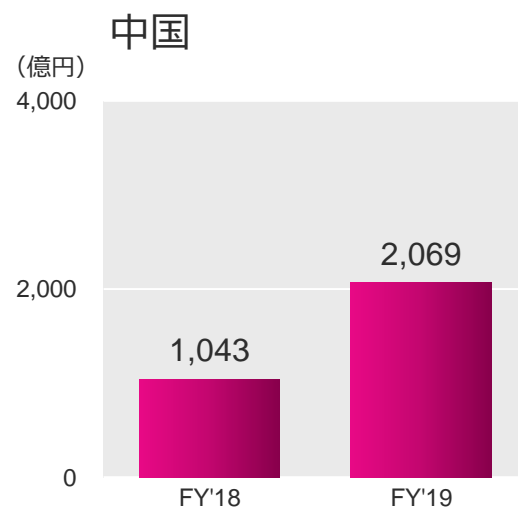
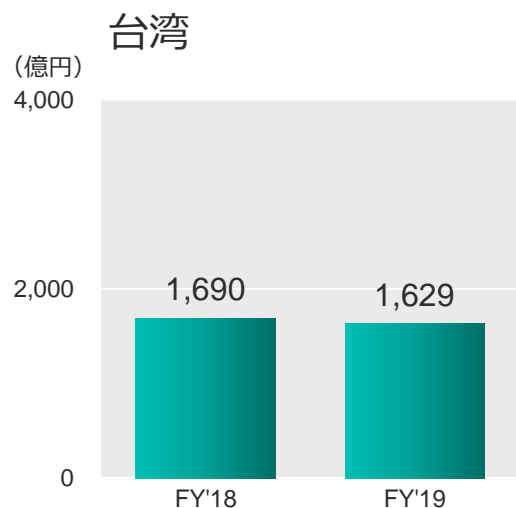
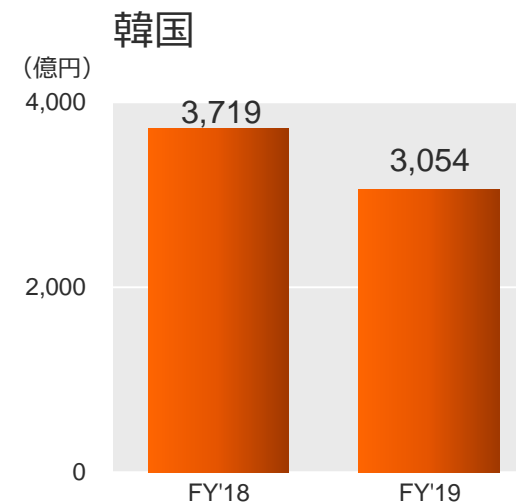
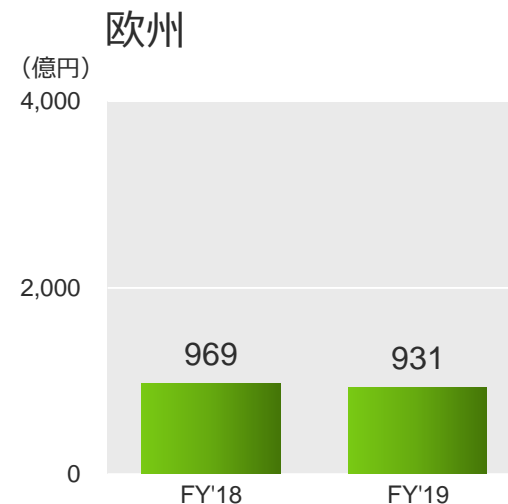
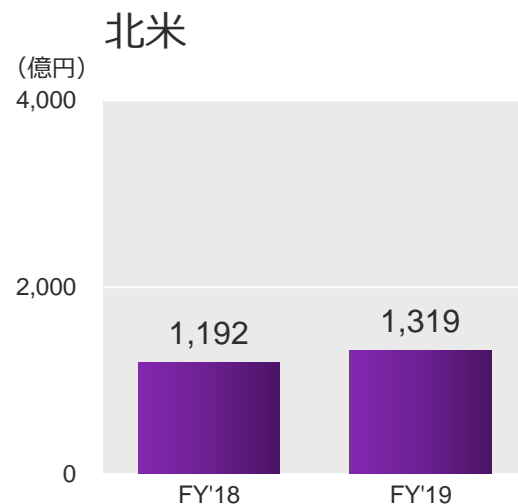
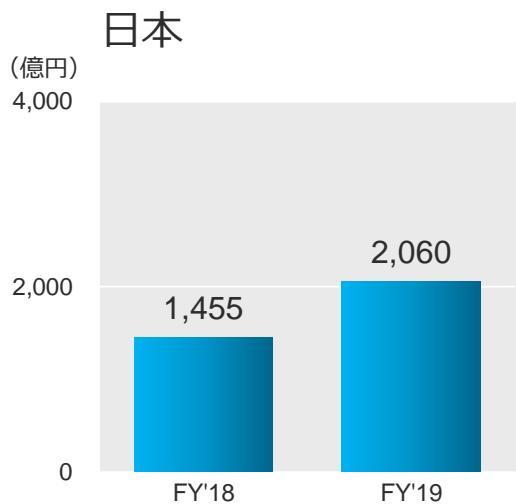
SPE部門 地域別売上高 (四半期)

(億円)
4,000

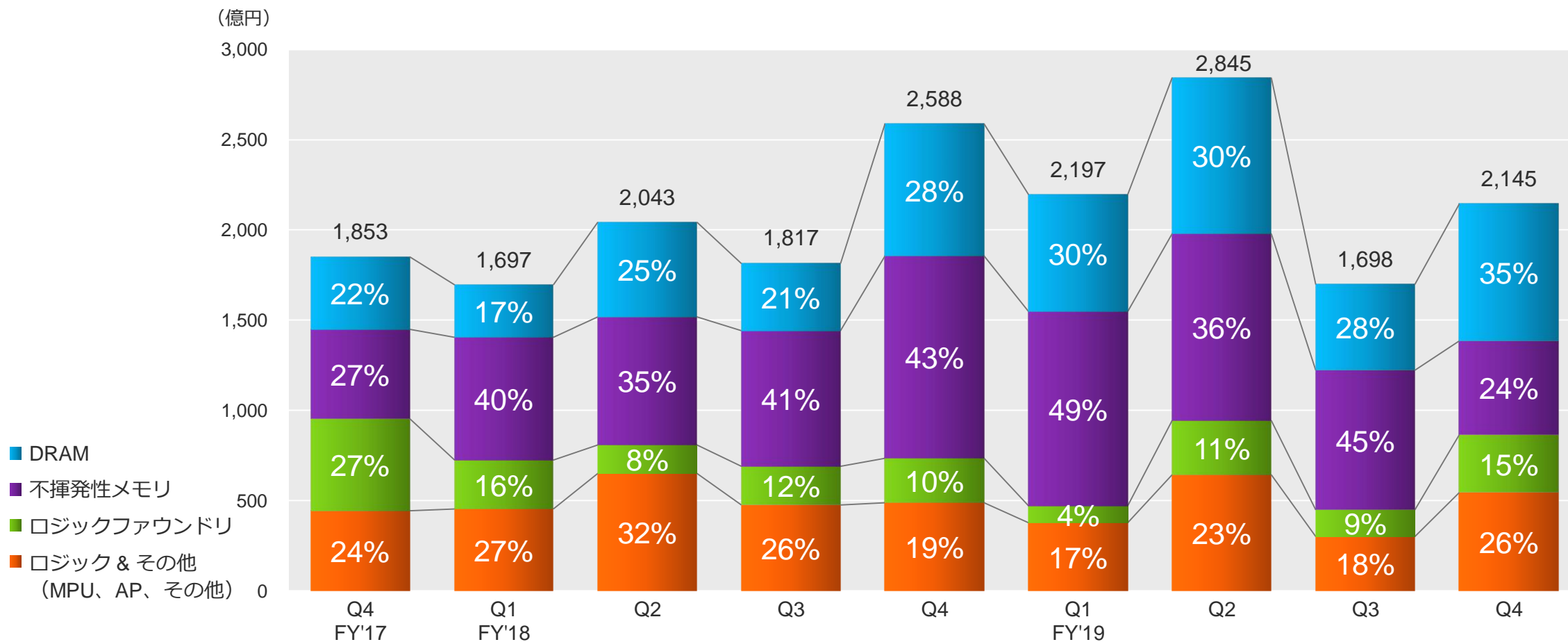


	Q4 FY'17	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4
日本	266	267	384	351	451	511	580	540	427
北米	254	240	320	291	339	284	459	227	347
欧州	329	253	269	196	250	177	313	186	253
韓国	555	683	1,017	794	1,223	889	865	609	689
台湾	747	458	366	421	443	263	480	293	591
中国	227	267	230	226	318	549	713	380	425
東南アジア・他	53	46	67	132	234	127	168	156	152

SPE部門 地域別売上高

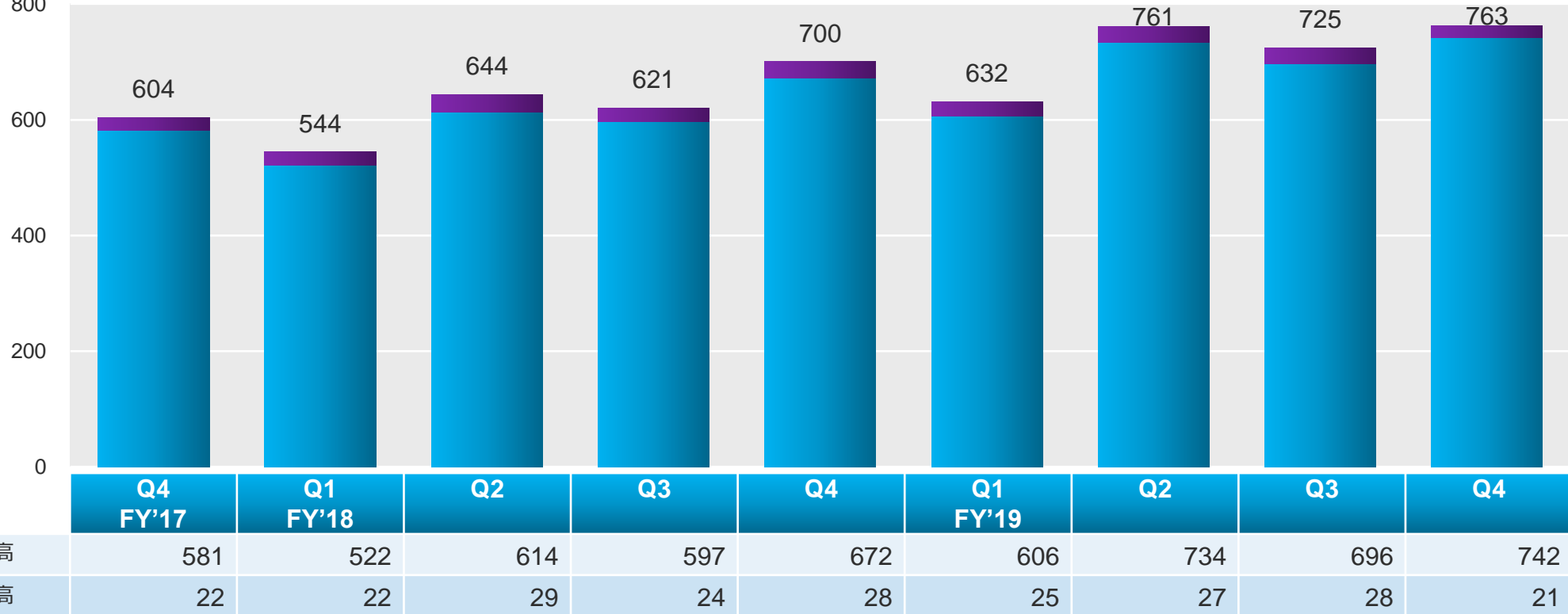


SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



フィールドソリューション売上高（四半期）

(億円)



TEL™

TOKYO ELECTRON